

证券代码：688093

证券简称：世华科技

公告编号：2026-024

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及使用募集资金 向全资子公司增加借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2027 年 5 月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益（以实际转出日的金额为准）以无息借款方式向全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）增加借款，用于“创新中心项目”的建设。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2023 年 6 月 7 日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,558,872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.09 元，共计募集货币资金人民币 389,999,994.48 元，扣除发行费用人民币 7,428,795.84 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 382,571,198.64 元，上述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 7 日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资

报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

（二）募集资金投资计划及使用情况

根据《苏州世华新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（注册稿）》、2023 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募投项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后实际拟投入募集资金金额（1） | 截至 2026 年 4 月 30 日累计投入金额（2） | 投资进度（3）=（2）/（1） | 状态 | 实施主体 |
|----|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1 | 新建高效密封胶项目 | 30,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,210.51 | 101.00% | 已结项 | 江苏世拓新材料科技有限公司 |
| 2 | 创新中心项目 | 32,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,248.12 | 78.10% | 建设中 | 世晨材料技术（上海）有限公司 |
| 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,257.12 | 9,263.60 | 100.07% | 不适用 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 |
| 合计 | | 72,000.00 | 39,000.00 | 38,257.12 | 36,722.23 | 95.99% | - | |

二、本次部分募投项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合募投项目“创新中心项目”的实际进展情况，在募投项目投资内容、投资规模、实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟调整“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期，具体如下：

| 项目名称 | 原计划预计达到可使用状态日期 | 延期后预计达到可使用状态日期 |
|--------|----------------|----------------|
| 创新中心项目 | 2026 年 05 月 | 2027 年 05 月 |

（一）“创新中心项目”延期的原因

公司“创新中心项目”于 2023 年 5 月开工建设。项目推进过程中，公司对项

目设计、施工、现场管理等各环节实施全流程管控，整体建设周期有所延长。该项目已于2026年1月完成综合竣工验收并投入使用，目前正在陆续进行研发设备的购置安装工作。截至2026年4月30日，公司以自有资金和募集资金累计投入该项目达31,789.72万元（不含税）。

结合市场环境、研发规划及研发设备评估、选型、采购周期，公司秉持审慎原则合理安排募集资金支付节奏，将在后续陆续支付和使用剩余部分2022年度募集资金，项目整体进度较原计划有所延后。经综合评估，公司决定将该募投项目预计达到完全可使用状态日期调整至2027年5月。

（二）募集资金的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行管理和使用。截至2026年4月30日，“创新中心项目”的募集资金余额为2,148.60万元，其中：使用闲置募集资金现金管理的余额为1,700.00万元，募集资金专项账户余额为448.60万元。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）预计完成时间及分期投资计划

公司基于审慎性原则，结合募投项目的实际进展情况，在募投项目投资内容、投资规模、实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将该募投项目预计达到完全可使用状态日期调整至2027年5月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进募投项目的实施。

（五）延期后按期完成的相关措施

公司将严格遵守募集资金使用相关规定，密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极优化资源配置，合理统筹，加强对募投项目的监督管理，推动募投项目按期完成。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资规模、实施主体、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

四、使用募集资金向全资子公司增加借款的情况

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司世晨技术缴纳已认缴但尚未全部实缴的注册资本 3,700.00 万元并提供不超过人民币 4,300.00 万元的无息借款以实施募投项目“创新中心项目”。公司拟在前述审议通过的基础上，将上述 8,000.00 万元募集资金存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益（以实际转出日的金额为准）以无息借款方式向世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”的建设。

五、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于 2026 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至 2027 年 5 月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额 8,000.00 万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益（以实际转出日的金额为准）以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”的建设。上述议案无需提交股东会审议。

（二）保荐人核查意见

华泰联合证券认为：公司本次部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、实施主体、募集资金投资用途等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的核查意见》。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026年5月29日